

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	易方达基金、中银基金、东方基金、国泰基金、长信基金、泰信基金、博道基金、财通基金、新华基金、华富基金、国寿安保基金、源乘投资、国晖投资、杭贵投资、大博通商医疗投资、圆信永丰、尚诚资产、卫宁私募、高竹私募、石锋资产、冰河资产、荷荷（北京）私募基金、红骅投资、中再资产、华能贵诚信托、华源证券、华创证券、富国基金、鹏华基金、宝盈基金、中庚基金、金鹰基金、前海联合基金、金之灏基金、成泉资本、红筹投资、汇丰晋信基金、幸福人寿保险、长城财富保险、阿尔法基金、国联安基金、睿远基金、盛熙私募基金、金科投资、乾图私募、惠升基金、民生加银基金、大家资产、中电科投资、天辰元信私募、旭冕投资、兴银理财、汐泰投资、益昶资产、中信证券资管、东方证券资管、国泰海通、中金证券、国元证券、国海证券、招商证券、东北证券、长江证券、华西证券、西南证券、五矿证券等 89 名投资者
时间	2025 年 08 月 24 日（周日）下午 19:00-20:00 2025 年 08 月 24 日（周日）下午 20:00-21:00

地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	1、董事会秘书邱靖琳 2、投关经理江正才
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司基本情况介绍：</p> <p>投关经理江正才先生详细介绍了公司发展的主营业务、技术优势和研发创新情况。</p> <p>公司与参会人员就以下问题进行了探讨：</p> <p>1、2025 年半年度整体经营情况。</p> <p>答：报告期内，公司实现营业收入 45,361.81 万元，同比增长 26.22%；归属于母公司股东的净利润为 6,714.20 万元，同比增长 144.18%；公司产品综合毛利率为 41.86%，同比增加 9.58 个百分点；公司基本每股收益为 0.63 元，较上年同期增长 142.31%。</p> <p>分产品来看，锡膏印刷设备实现营业收入 29,198.89 万元，同比增长 53.56%；点胶设备实现营业收入 6,049.74 万元，同比增长 26.31%；封装设备实现营业收入 5,917.62 万元，同比下降 38.85%；柔性自动化设备实现营业收入 2,451.18 万元，同比增长 71.33%。</p> <p>2、请简要介绍一下公司净利润同比增长较快的原因？</p> <p>答：报告期内，净利润同比增长较快，主要原因系营业收入的增长及综合毛利率的提升。收入增长原因主要系人工智能投资规模增加、AI 服务器需求的增长、消费电子需求回暖、新能源车渗透率的提升等带来 PCBA 中 SMT 设备需求的增长。高毛利率业务收入结构占比的提升对综合毛利率的提升有积极影响，基板复杂度提高和高价值 PCB 组装需求的增长对锡膏印刷设备的稳定性、精度、智能化有更高的要求，从而增加高端设备的需求。</p>

3、半导体业务的布局，当前进展，未来展望公司在手订单情况？

答：报告期末，合同负债 1.33 亿元，创历史新高，较期初增长 32.98%，在手订单饱满。

4、公司在研发方面有哪些进展

答：2023 年度、2024 年度和 2025 年半年度研发投入分别为 7,446.01 万元、7,812.78 万元、4,149.59 万元，占营业收入的比例分别为 10.06%、9.12%、9.15%。研发费用的持续投入、完善的研发管理和较强的研发团队为公司形成体系化的技术升级能力和打造不断深化的技术创新优势提供了重要保障，也为公司积累了大量技术成果。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已取得专利 285 项，包括 104 项发明专利、176 项实用新型专利和 5 项外观专利，此外还有 30 项软件著作权。

5、请介绍一下公司在研发创新方面的进展情况？

答：研发创新方面，公司坚持“好产品是设计出来的”研发理念，持续加大对研发中心的投入，完善研发中心共性技术及共性模块的建设，优化并灵活运用共性技术模块，提高研发效率。报告期内，研发中心注重效率提升与成果推广，在共性技术与共性模块领域取得了较好进展，如建立了各事业部共用的视觉图片测试库；本地部署了大语言模型及相应知识库，用于视觉方案检索及测试；点胶阀部门，结合仿真技术实现“零气泡”；电气工程领域继续优化和推广能嵌入到机械模组的控制驱动产品。

6、2025 实验室有什么进展？

答：报告期内，2025 实验室多项技术取得了新进展，如完成了 Calibration 标定系统（图像、运动、对位关系模型），并在多款设备中进行了推广；KGD 测试机的高温测试项的材料学&工艺学方面完成了高温高压冲氮测试环境设备温升模

	<p>型；共晶机固化的材料工艺学研发，运控的加速度 S 曲线解耦、运动前瞻、振动抑制、PID 算法测试系统等方面的完善。</p> <p>7、电子装联下游应用情况</p> <p>答：根据行业报告，PCB 下游应用中，消费电子大概占比 33%，网络通信占比约 20%，汽车电子占比约 20%，医疗器械、家电等约占 27%。公司在消费电子和网络通信领域占比较高，汽车电子、医疗器械、半导体目前占比较低。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 8 月 25 日